

TIC™800G系列 是一种高性能低熔点导热界面材料。在温度50℃，TIC™800G开始软化并流动，填充散热片和积体电路板的接触接口上细微不规则间隙，以达到减小热阻的目的。TIC™800G系列在室温下呈可弯曲固态，无需增强材料而独立使用，免除了增强材料对热传导性能的影响。

TIC™800G系列 在温度130℃下持续1000小时，或经历-40℃到125℃的反复循环测试，其导热性能仍不会减退。在工作温度下，其中相变材料软化的同时又不会完全液化或溢出。



适用于:

- 》 高频率微处理器
- 》 笔记本和桌面计算机
- 》 计算机服务器
- 》 内存模块
- 》 高速缓存芯片
- 》 IGBTs

最小热阻系列:

- 》 0.014℃-in²/W 热阻
- 》 室温下具有天然黏性, 无需黏合剂
- 》 散热器无需预热

TIC™800G 系列特性表

产品名称	TIC™805G	TIC™808G	TIC™810G	TIC™812G	测试标准
颜色	灰色	灰色	灰色	灰色	目视
厚度	0.005" (0.127mm)	0.008" (0.203mm)	0.010" (0.254mm)	0.012" (0.305mm)	****
厚度公差	±0.0008" (±0.019mm)	±0.0008" (±0.019mm)	±0.0012" (±0.030mm)	±0.0012" (±0.030mm)	****
密度	2.6g/cc				氦气比重瓶
工作温度	-40℃~125℃				****
相变温度	50℃~60℃				****
热传导率	5.0 W/mK				ASTM D5470 (修正)
热阻抗 @ 50 psi(345 KPa)	0.014℃-in²/W 0.09℃-cm²/W	0.020℃-in²/W 0.13℃-cm²/W	0.038℃-in²/W 0.25℃-cm²/W	0.058℃-in²/W 0.37℃-cm²/W	ASTM D5470 (修正)

标准厚度:

0.005"(0.127mm) 0.008"(0.203mm) 0.010"(0.254mm) 0.0012"(0.305mm)

如需不同厚度请与本公司联系。

标准尺寸:

10" x 16"(254mm x 406mm) 16" X 400' (406mm X 121.92M)

TIC™800G 系列片料供应时附有白色离型纸及底衬垫，模切半断加工可提供拉手,也可提供模切成单个形状型试提供。

压敏黏合剂:

压敏黏合剂不适用于TIC800™ G系列产品。

补强材料:

无需补强材料。



導熱硅膠片 | 相變化材料 | 導熱矽膠布 | 導熱膏 | 導熱雙面膠 | 導熱塑料 | 導熱灌封膠 | RTV硅膠 | 陶瓷散熱片 | 石墨片 | 導熱粘著劑

加拿大Canada
TEL: +001-604-2998559
E-mail: frances@ziitek.com.tw
Http://www.thermazing.com

台灣Taiwan
TEL: +886-2-22771007
E-mail: frances@ziitek.com.tw
Http://www.ziitek.com.tw

東莞Dongguan
TEL: +86-769-38801208
E-mail: frances@ziitek.com.tw
Http://www.ziitek.com.cn

昆山Kunshan
TEL: +86-512-57816297
E-mail: kelvin@ziitek.com
Http://www.ziitek.com.cn

杭州Hangzhou
TEL: +86-571-63850366
E-mail: alex@ziitek.com
Http://www.ziitek.com.cn

長沙Changsha
TEL: +86-731-86949836
E-mail: jor@ziitek.com
Http://www.ziitek.com.cn

以上資料與說明相信是可靠的但不作為法律的解釋或保證。用戶須進行充分的測試與確認上述訊息適合用戶所提出任何特殊的产品與應用